

FY2026 IR

Disclaimer

본 자료는 재무제표 및 향후 전망에 관한 내용을 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.


본 자료는 객관적 기준 등을 참고하여 작성하였으나 일부 예상, 전망 또는 주관적 판단에 의한 표현이 포함되어 있을 수 있고, 향후 환경의 변화, 상이한 데이터 집계기준 등에 의하여 본 자료와 일치하지 않은 다른 숫자와 해석이 도출 될 수도 있음을 인지하시기 바랍니다.

따라서 여기에 포함되어 있는 서술 정보만을 믿고 이 정보에만 의존한 투자결정을 내리지 말아야 하며, 투자 책임은 전적으로 투자자 자신에게 있음을 밝혀 드립니다.



Contents

- 2026년 1분기 실적요약
- 회사소개
- 경영환경 및 전망
- 별첨



STAGE 1

2026년 1분기 실적요약

'26년 1분기 실적요약 (연결 재무제표 기준)

'26년 1분기 매출액은 551억으로 전년 동기대비 -5.8% 영업이익은 17억으로 -37.6% 감소함

(단위: 억원)

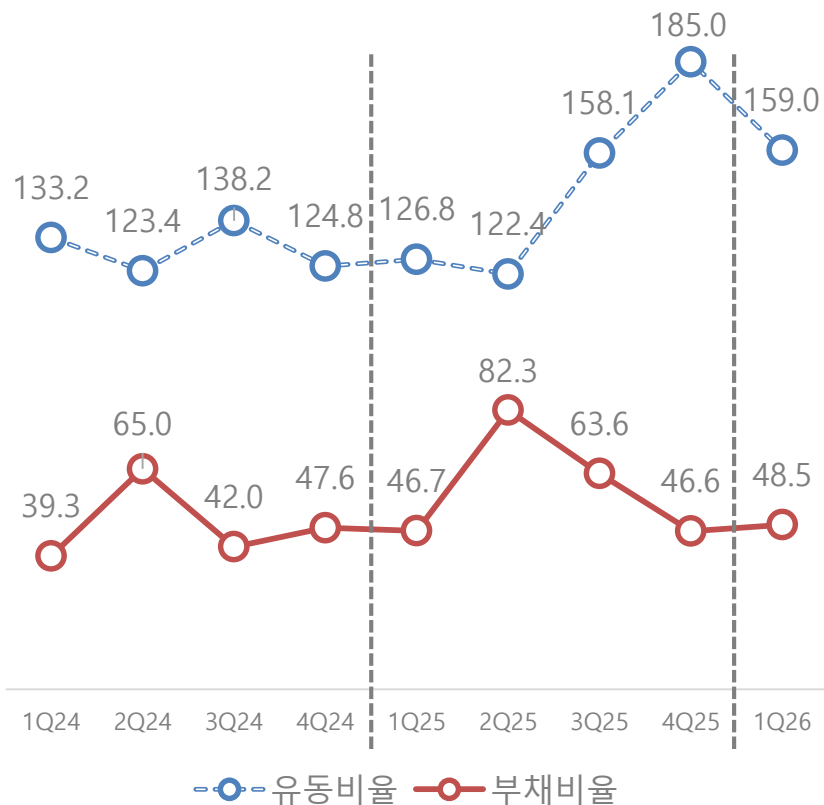
	2025년 1Q	2025년 4Q	2026년 1Q	증감률	
				QoQ	YoY
매출액	615	585	551	-10.5%	-5.8%
조립모듈(хин지)	133	210	133	0.0%	-36.7%
자동차부품	64	51	53	-17.2%	3.9%
기타(로봇, 통신장비, ATM, IDC 등)	418	324	365	-12.7%	12.7%
매출원가	520	537	471	-9.4%	-12.3%
매출총이익	95	48	80	-16.2%	67.6%
판관비	58	24	63	8.3%	161.0%
영업이익	37	24	17	-54.7%	-28.5%
영업이익률	6.0%	4.0%	3.1%	-3.0%p	-1.0%p
EBITDA	96.1	81.7	72.3	75.2%	88.5%
EBITDA이익률	15.6%	14.0%	13.1%	-2.5%p	-0.9%p
당기순이익	52	18	3	-94.4%	-83.4%
당기순이익률	8.5%	3.0%	0.5%	-8.0%p	-2.5%p

'26년 1분기 실적요약 (연결 재무제표 기준)

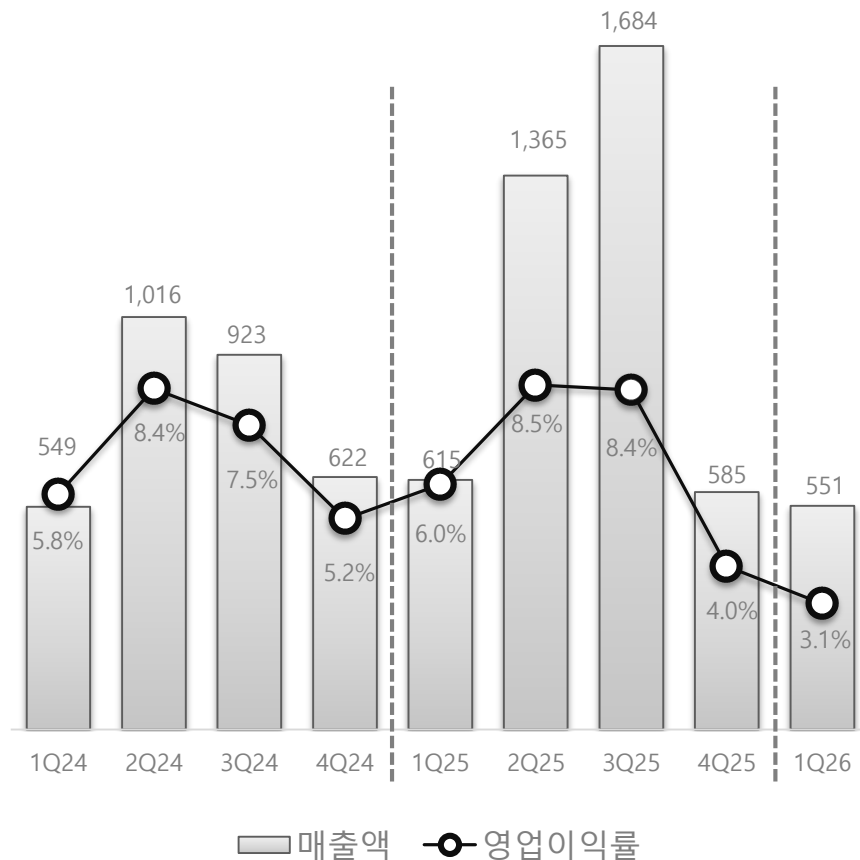
'26년 1분기 기준 유동비율 159.0%, 부채비율 48.5%로 안정적으로 유지되고 있음

주요 재무비율

(단위 : %)



분기별 매출액 / 영업이익률 추이

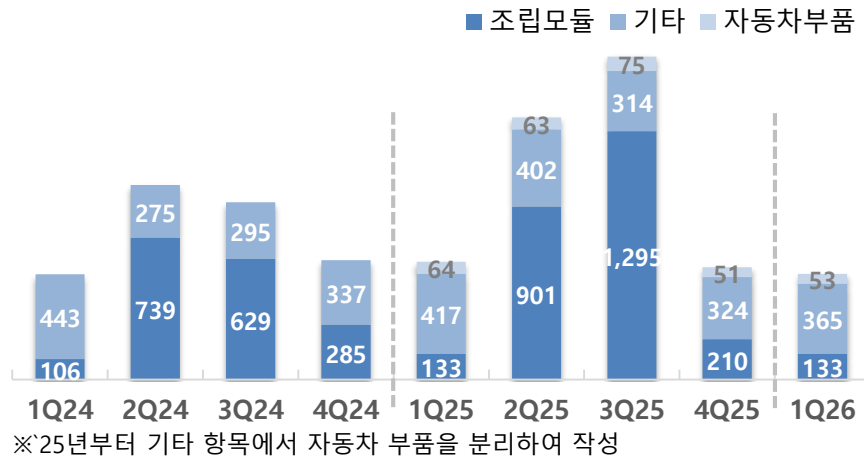


'26년 1분기 실적요약 (연결 재무제표 기준)

Ti-IDC의 매출이 감소하였으나, 신규사업(로봇, 통신, ATM등) 매출 증가로 분기 매출 감소폭 만회

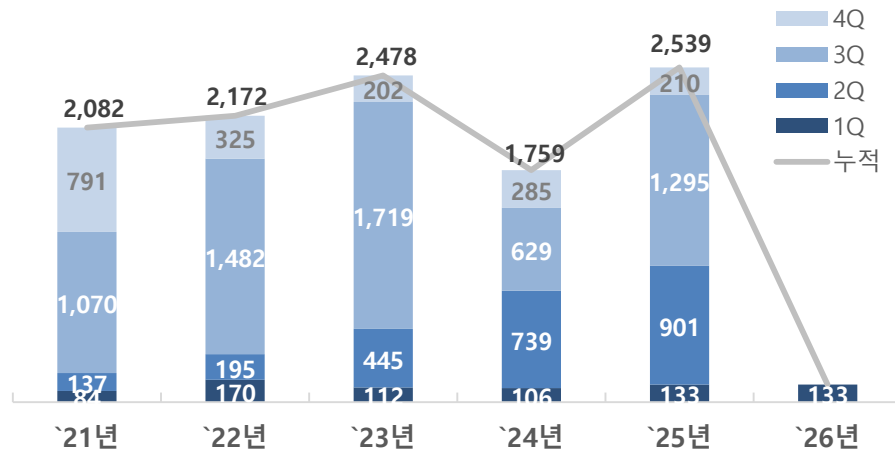
■ 분기별 매출구성

(단위 : 억원)



■ 연도별 조립모듈 매출추이

(단위 : 억원)



■ 주요 사업현황 및 전망

① 조립모듈


- '26년 폴더블폰 라인업 추가 예정(가칭 와이드폴드)
- '26년 북미 A사 폴더블폰 출시 예정에 따른 시장확대 기대
- 고객사 다변화 지속 추진(C-brand 확장 계획)

② 메탈케이스 및 기타

- '26년 1분기 Ti-IDC 감소에 따른 매출 하락
- 신규사업 지속 매출 증대 (로봇, 통신장비, ATM 등)

③ 자동차 부품

- '25년부터 사업영역 본격화
- '26년 칩소몰딩 디스플레이 브라켓의 매출기여 반영 예정
- 무빙메커니즘 추가 수주 체결 및 고객사 다변화 추진
- 인도법인, 비스테온 공급업체 등록 (칩소몰딩)



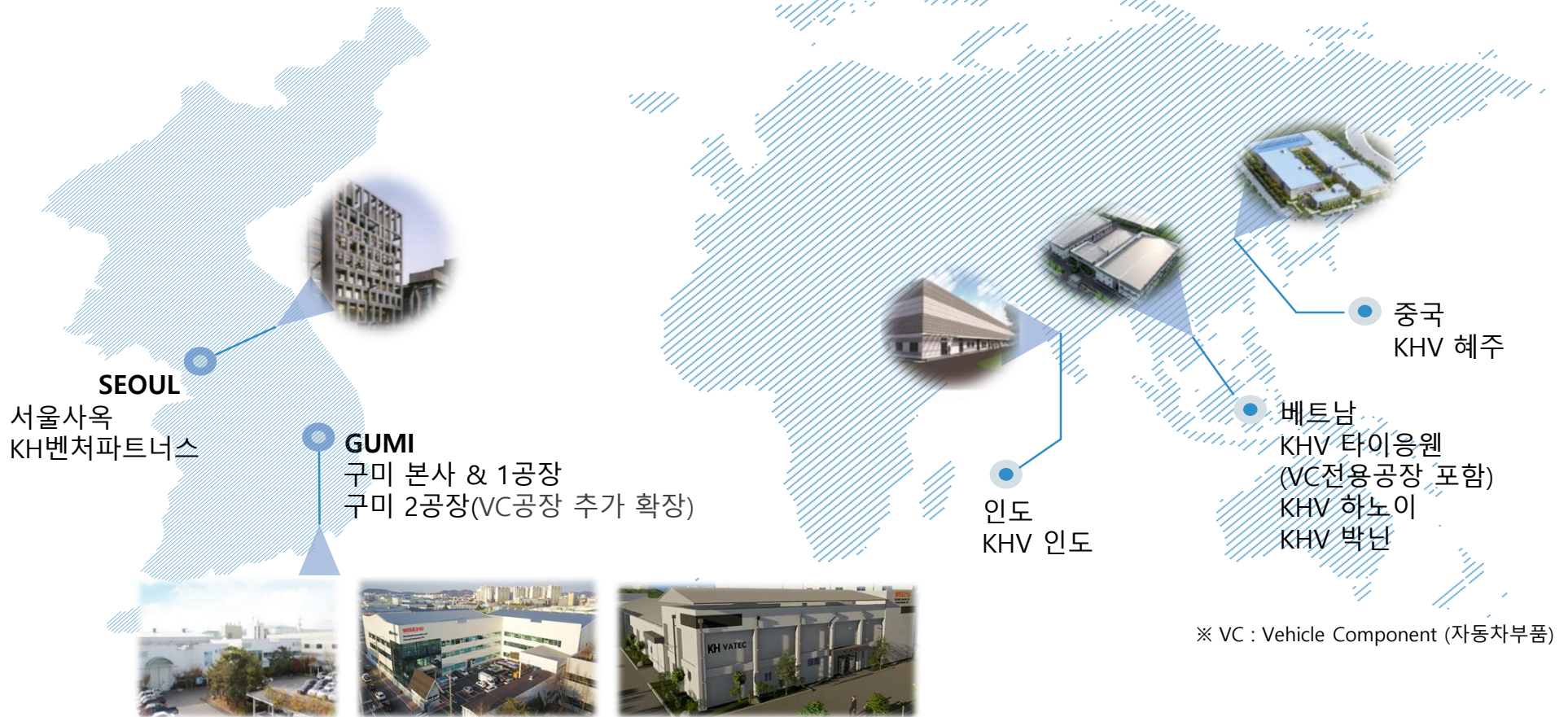
STAGE 2

회사소개

1. 주요사업장

1) 국가별

KH바텍은 국내에는 서울사무소와 구미 본사 및 1,2공장을 운영 중이며 해외로는 중국, 베트남, 인도에 해외법인을 운영하고 있음



1. 주요사업장

2) 지역별

KH바텍은 국내에는 구미본사(`25년 VC 공장 확장)와 서울사무소를 운영 중에 있으며 해외로는 중국(혜주), 베트남 (타이응웬, 하노이-박닌), 인도(그레이트 노이다)에 해외법인을 운영하고 있으며, 타이응웬 지역에 신규 건설한 VC전용공장을 `25년 4월부터 가동함

(`26년 3월말 기준)



한국 (서울, 구미)



KHV 타이응웬



KHV 하노이
(박닌 포함)



KHV 혜주



KHV 인도

설립일 : 1992년11월
직원수 : 175명
대지 : 5,700평
건평 : 3,735평

설립일 : 2023년 4월
직원수 : 349명
대지 : 37,000평
건평 : 16,000평

설립일 : 2018년 1월
직원수 : 1,851명
대지 : 15,000평
건평 : 11,450평

설립일 : 2010년 6월
직원수 : 349명
대지 : 24,000평
건평 : 20,000평

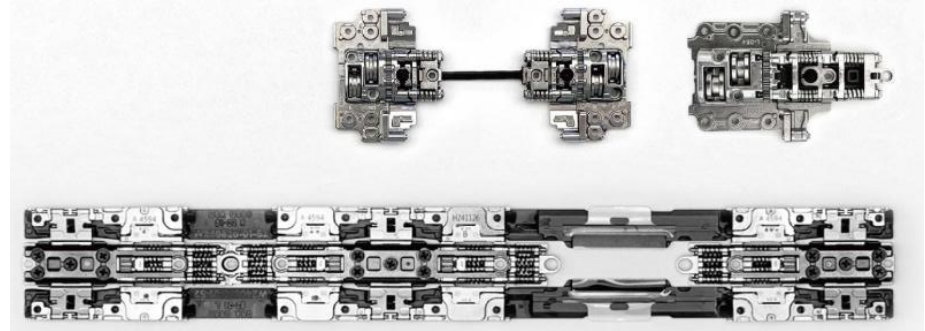
설립일 : 2019년 3월
직원수 : 1,627명
대지 : 23,000평
건평 : 6,500평

KH바텍은 지속성장하는 폴더블 스마트폰의 핵심부품인 힌지를 생산하고 있으며, 메탈케이스 제품은 이미 세계 최고의 수준으로 인정받고 있음

Foldable Hinges

KH바텍은 독보적인 힌지 설계 능력, 금속분말 사출 성형(MIM) 기술, 조립기술을 바탕으로 폴더블 힌지를 생산하고 있음.

폴더블 힌지란, 폴더블 OLED를 기반으로 한 폴더블 폰의 화면을 접었다 펼 때의 패널이 맞닿는 충격을 최소화시켜 구동을 가능케 하며, 새로운 폼팩터 시대에 맞춰 폴더블 뿐만 아니라, Rollable, Slidable 등 다양하게 적용될 스마트폰의 핵심 부품임.



IDC (Insert Die-Casting)

금속 블록을 통째로 가공하는 공법을 탈피하여, 외장면은 알루미늄 압출재, 스테인리스, 티타늄 등의 합금을 적용하여 아노다이징, 증착 등의 기술로 외장면을 처리하고, 내장면은 알루미늄 다이캐스팅을 구현하여 블록을 통째로 가공하는 방식대비 절삭 가공 시간을 획기적으로 줄인 KH바텍만의 독보적인 기술.



VAW(Value Added Welding)

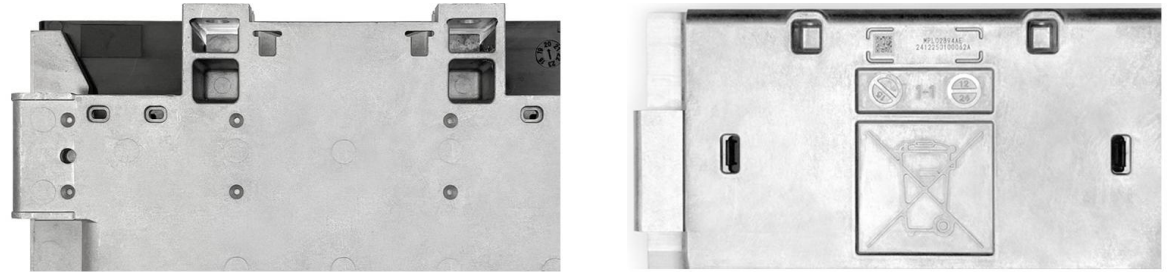
당사가 자체 개발한 VAW(Value Added Welding) 기술은 Die-Casting 내장품과 알루미늄 외관용 케이스를 접합하는 기술로써 당사의 고유한 특허 기술임. VAW기술을 활용할 경우 생산비용과 생산 시간을 크게 단축 시킬 수 있어 국내외 고객들로 부터 저가형 알루미늄 케이스용 최상의 기술로 인정받고 있음.



KH바텍의 전기자동차용 End Plate 및 전장품을 개발~제조를 하고 있으며, 로봇 및 열전달과 전자파차폐가 탁월한 네트워크 제품들로 사업모델이 확장되고 있음

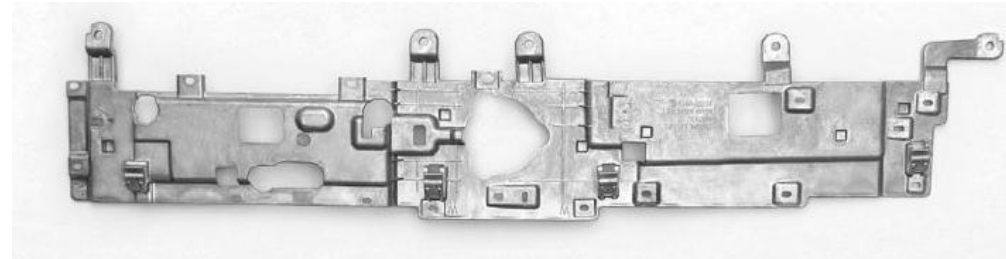
배터리 (End Plate)

배터리 CELL을 내·외충격으로부터 보호하는 핵심 부품인 End Plate를 고진공 Die-Casting, Insert Die-Casting 기술로 자체개발하여 생산 중에 있음.



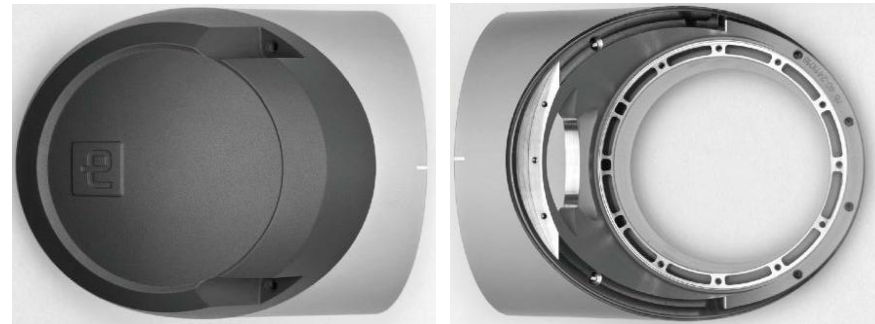
Display Bracket & 기타

차량용 디스플레이 브라켓을 알루미늄 및 마그네슘으로 생산하고 있으며, 특히 마그네슘 제품은 칩소몰딩 공법을 활용하여 가볍고 친환경적임. 또한 소자의 열을 흡수하여 외부로 방출하는 알루미늄 HEAT SINK 및 DRL, RCL의 브라켓 부품을 생산하고 있음.



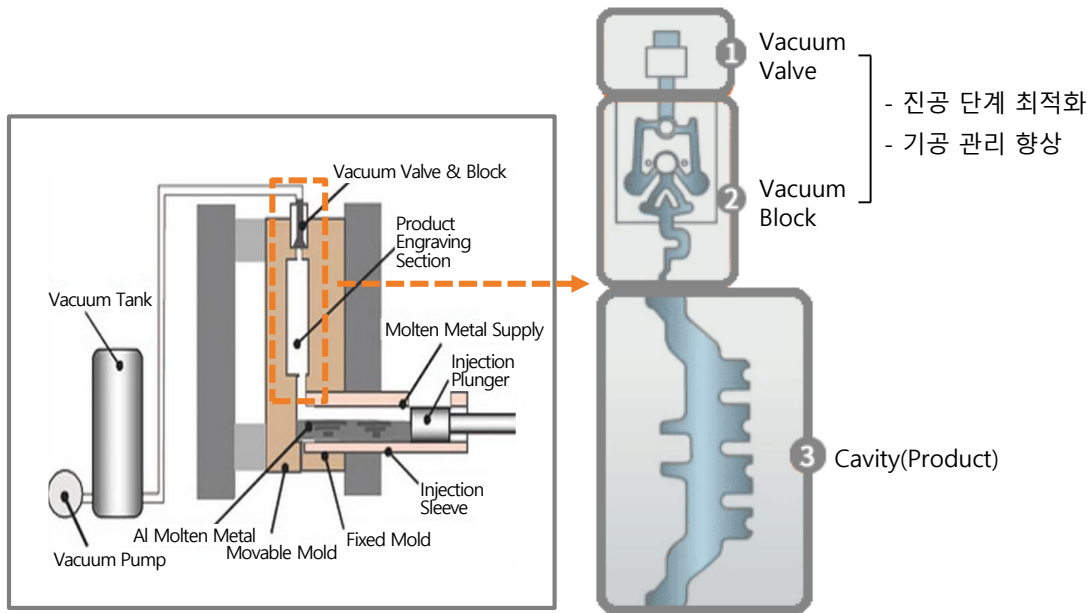
ROBOT

KH바텍은 연평균 성장률이 30% 이상으로 예상되는 로봇산업 분야에 필요한 초정밀 기구물 개발에도 박차를 가하고 있음. 미래 산업현장에 필수적인 협동로봇의 부품을 필두로 하여 견고하면서도 가벼운 그리고 고신뢰성에 특화제품 분야로 진출하고 있음.



진공 다이캐스팅

- ① 녹은 금속 사출 전 진공선행
- ② 다이캐스팅 과정 내 기공 감소 관리
- ③ 윤활유 및 연소에 의한 오염 최소화



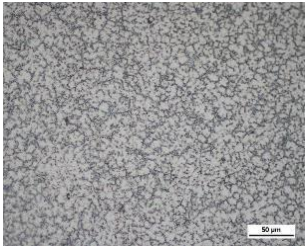
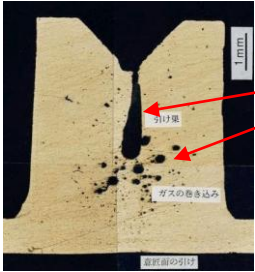
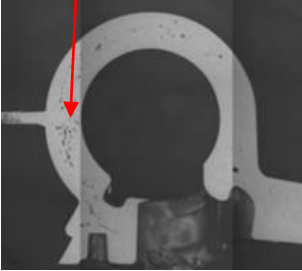
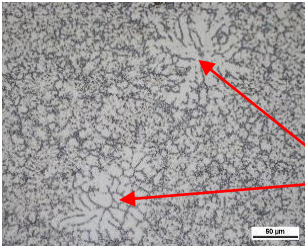


일반 다이캐스팅 vs 진공 다이캐스팅

구분	일반	진공
Gate		
Vent		
일반 D/C 대비 내부기공이 현저하게 감소		
Dia-Cut		
일반 D/C의 기공 크기가 50~70μm인데 반하여 기공 크기가 20μm 이상 더 작음		

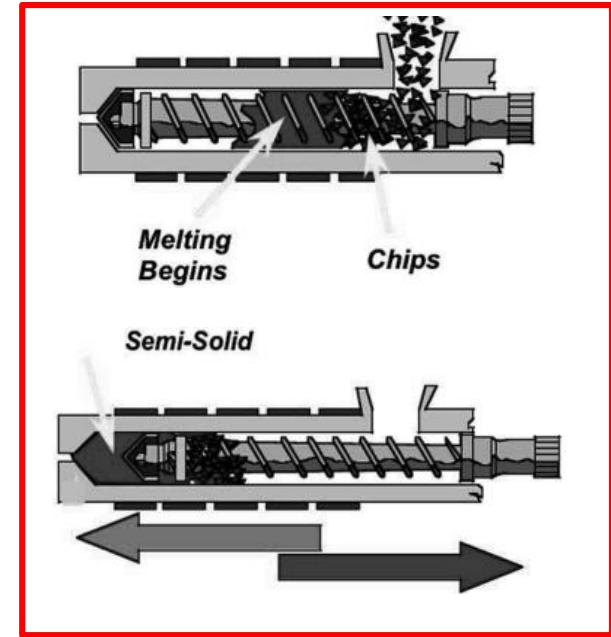
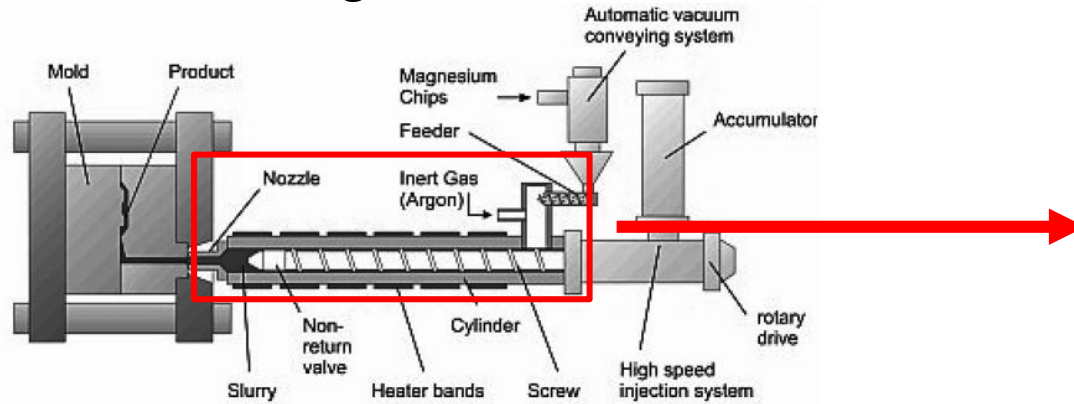
D/C : Die-Casting(다이캐스팅)

칩소몰딩과 Cold chamber 기술적 차이는 아래와 같음

구분	Thixomolding (칩소몰딩)	Cold chamber
용융방식	가열 실린더 + 스크류	용해로 (용탕과 사출부가 분리)
용해온도	585~670°C	640~670°C
보호가스	Ar (아르곤가스)	SF6 (육불화황)
재료형태	Mg chip	잉곳
사출압력 (Mpa)	62~103	400~800 (고압)
특징	<ul style="list-style-type: none"> * 반응용 상태로 금형의 열충격 적음 → 금형수명 ↑ * 제품내부 조직이 치밀하고 미세기공이 현저히 적음 * 친환경 생산방식 : 전기료 ↓, 환경문제 유발하는 SF6無 * 고가의 칩형태 재료 필요 및 스크류 마모 심함 	<ul style="list-style-type: none"> * 주조 압력을 높일 수 있어 두꺼운 중대형 부품 제조 가능 * 소모품이 저렴하고 교체가 간편 * 특정 소재에 종속되지 않고, 대량생산 적합
<p>① 노트북 케이스 Screw Boss 단면 [광학 현미경]</p> <p>② 휴대폰 Hinge 단면 [X-Ray]</p> <p>③ Micro 조직 [광학 현미경]</p>	<p>①  낮은 온도 (580~600 °C)로 사출시 가스 기공 결함감소</p> <p>②  결정립이 치밀하고 규칙적</p> <p>③  50 μm</p>	<p>①  높은온도 (650 °C)로 사출시 응고수축으로 인한 가스기공 다수 발생</p> <p>②  결정립이 굵고 불규칙</p> <p>③  50 μm</p>

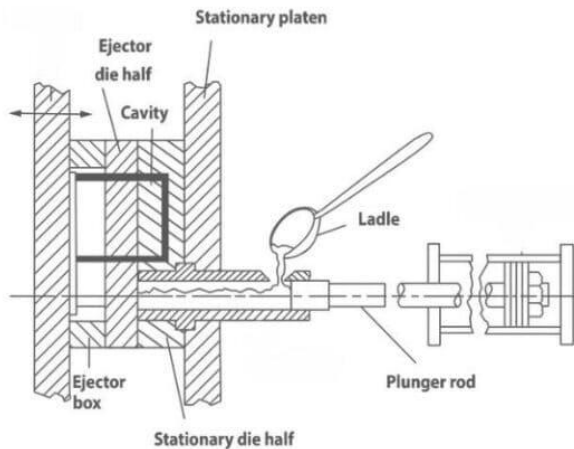
※ 2011.10월 한국마그네슘기술연구조합 자료 인용


Thixomolding



Cold chamber

(기존 KH바텍 설비)



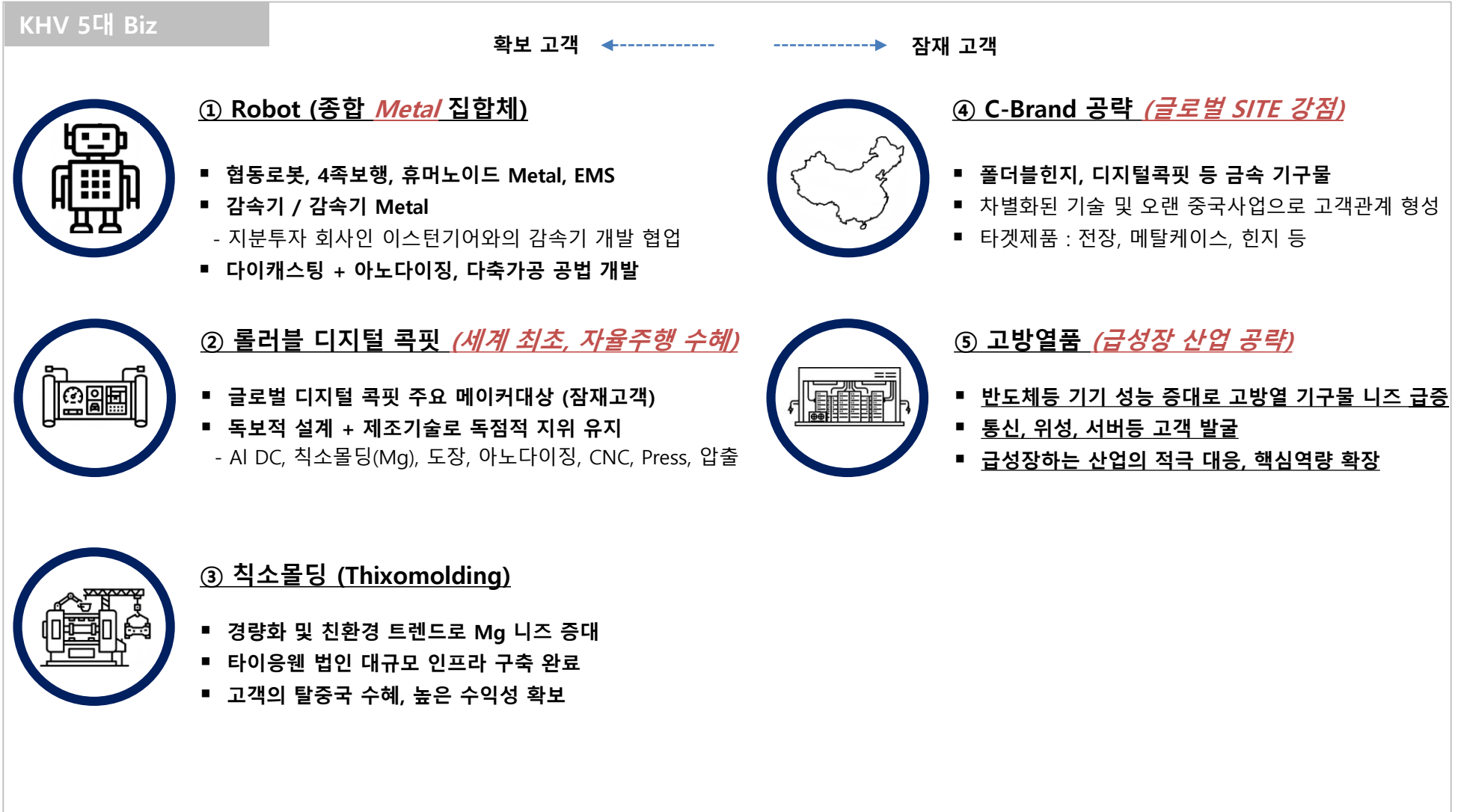


STAGE 3

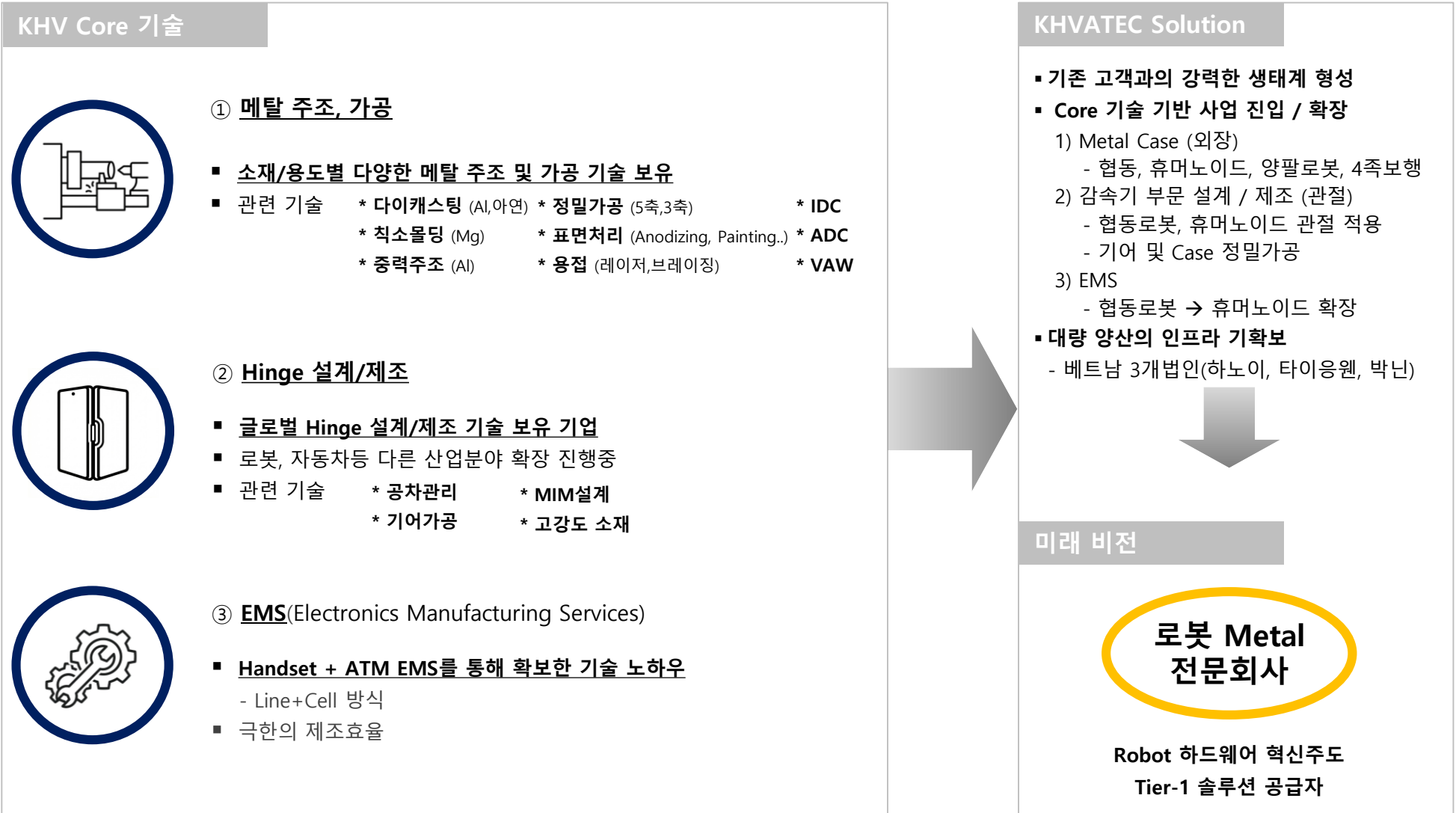
경영환경 및 전망

1. KHV 미래 5대 Biz

KHV은 중기 비전으로 WISE210을 선포하여 실행중에 있으며, 이를 위하여 5대 미래 사업 영역을 설정하고, 투자 및 기술개발을 가속화 하고 있음

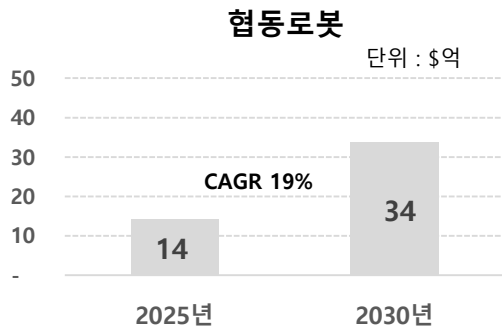


Robot사업은 KHV의 기반이 되는 Core기술을 필요로 하는 종합 Metal 사업으로 Metal Case뿐만 아니라 감속기 부문 설계 및 제조와 로봇 EMS사업으로 확장하고자 함

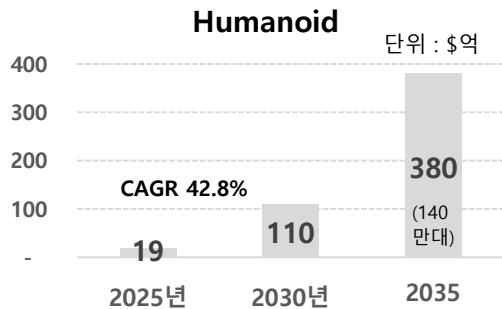


Robot 시장은 2030년까지 급격한 성장이 예상되며, 핵심 부품인 감속기 시장 확대에 따라 자체 개발 및 공동 연구개발을 진행하고 있음

로봇 시장(종류) 현황



MarketsandMarkets '25년



골드만삭스, BCC Research '25년

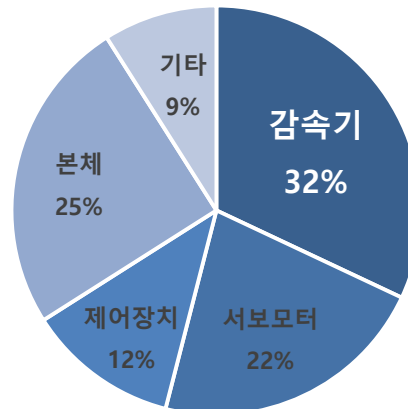
로봇 감속기 현황

감속기 사용

로봇 유형	관절수 (DOF)	감속기 소요량 (예상)	KHV 관련
협동로봇 (6축)	6개	6개	1) Metal Case 2) 자체 감속기 설계
휴머노이드 (전신)	28 ~ 50개	28개 이상	
로봇 핸드 (5지)	10 ~ 20개	10개 이상 초소형	MIM, 이스턴기어 협력

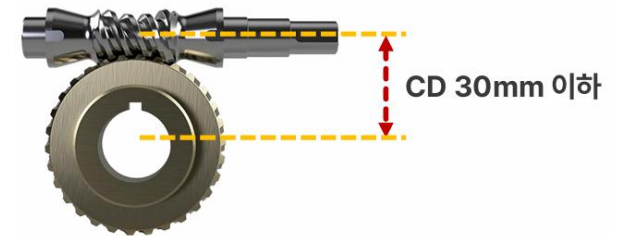
골드만삭스, BCC Research '25년

협동로봇 부품 비중



유진투자증권 '25년

이스턴기어(MOU체결) 초소형 월기어



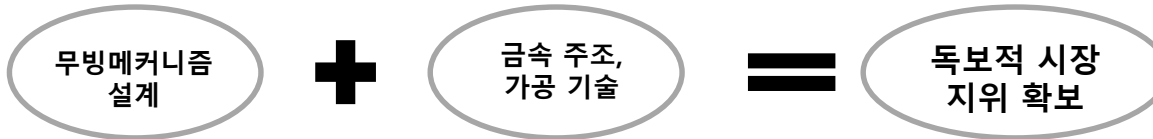
1-2. 디지털 콕핏 (무빙+칙소몰딩)

최근 차량의 럭셔리화를 위해 롤러블 디지털콕핏 제품들의 수요가 증가하고 있으며, KH바텍은 기반기술을 활용하여 적극적으로 대응하여 독보적인 시장 지위를 유지하고 있음

시장동향 자율주행과 럭셔리 브랜딩을 위한 롤러블 디지털콕핏의 수요 증대

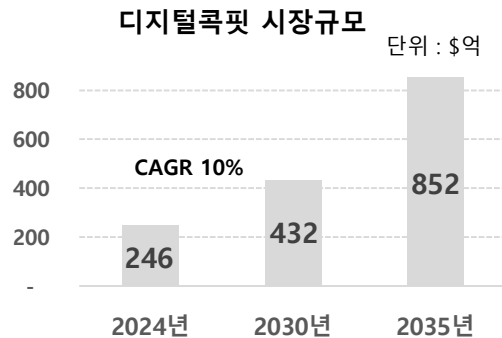
주요기능 1) 최소정보 모드 : 1/3노출, 2) 일반주행 : 2/3노출, 3) 미디어모드 : Full 노출 (충전or주차)
4) 수납모드 : 0% 노출 → 미니멀 인테리어 구현

KH바텍

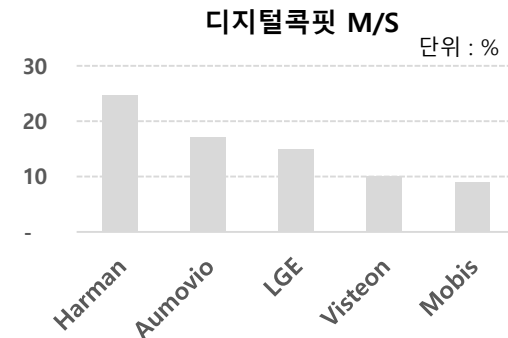


- * 폴더블 + 롤러블 Hinge 기술 활용
- * KHV Core 기술 기반 시장선도

산업동향



MarketsandMarkets '25년



기업발표자료

3. 최근 업계 동향 (기존사업)

최근 스마트폰 업계는 폴더블 스마트폰의 성장 및 북미 A사 스마트폰의 Ti 채용 확대가 기대 중이며 전장시장의 성장 역시 기대감이 커짐에 따라 KH바텍은 이에 맞는 솔루션을 적용 하고자 함

업계 기술 / 트렌드



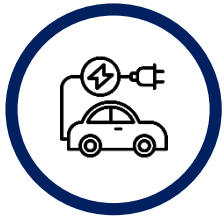
① 폴더블 스마트폰

- 국내 고객사의 폴더블폰은 '19년 이래로 '24년 첫 역성장이 있었으나 중화권 업체들의 경쟁적인 신규제품 출시 및 북미 "A"사의 폴더블폰 기대
- '26년 약 23백만대, '27년 약 34백만대로 성장 전망 (하나, 대신증권 추정)
- 폴더블 폼팩터의 확대 (WIDE, 노트북)



② 메탈케이스의 확대

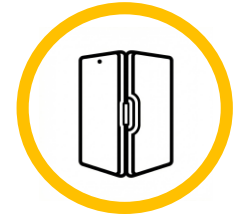
- 북미 A사 Ti 채용 영향
 - Bar타입 채택 확대 및 폴더블폰 확대 적용 기대
- 갤럭시 A시리즈 메탈케이스 채택 (A5) → A3확대 기대



③ 기타 전장부품

- EV 시장 대비 ESS 시장 성장 본격화 (LG에너지솔루션 기준 '26년 예상매출 EV 10.2조원, ESS 12.1조원, 미래에셋증권 추정)
- 국내 주요 전장업체의 수주잔고 우상향 및 '26년부터 본격 매출반영
- 전장부품 시장이 '25년부터 스마트폰 부품 시장 추월 예상

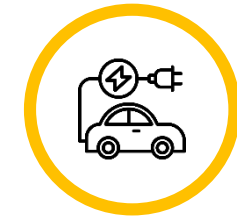
KHVATEC Solution



Foldable Hinge



Insert Die-Casting (IDC)
Value Added Welding (VAW)



Display Bracket / End Plate

4. ESG 경영 강화

ESG 경영의 중요성이 꾸준히 증가함에 따라, '21년 KH바텍도 ESG 경영 도입을 선포하고 탄소배출감소, 지역사회 기여, 지배구조 개선 등 ESG 경영을 가속화 중임



KHV ESG 경영 강화


- ESG란? 친환경, 사회적 책임 경영, 지배구조 개선 등 투명경영을 고려해야 지속가능한 발전이 가능하다는 철학
- KH바텍은 '21년 본격적인 ESG 경영철학을 도입하기 시작
- '26년에도 ESG경영은 더욱 중요한 키워드가 될 것으로 전망됨에 따라 KH바텍은 꾸준히 ESG 경영을 강화할 예정

✓ KH바텍의 ESG 주요활동

- '23~'24년 **한국ESG 기준원 ESG 평가등급 A**
- '24~'25년 **서스틴베스트 A등급, CDP B등급**
- '24년~'25년 **CDP SEA 평가 A- 등급** (공급망 참여평가)
- 주주가치 제고를 위한 현금배당 결정 (**'25년 배당성향 39%**)
 - '24~'25년 분기배당 시행 / '25년 배당 분리과세 정책 적용
- KHV-ESG 환경부문 주요 목표 설정 및 실적 공개 (자사 홈페이지)
- '24년 태양광 발전(구미 2공장)으로 탄소중립에 기여
- 한국 및 해외법인 지역사회 나눔행사 참석 / 물품 후원

✓ '26년 KH바텍 ESG 주요 목표

구분	내용
종합목표	서스틴베스트, CDP A등급 달성
E (환경)	<ul style="list-style-type: none"> 온실가스 배출 감소 / 재생에너지(전력) 사용 태양광 발전 확대(구미 1공장) Scope 3 배출량 개선(국내 법인부터 순차적 개선)
S (사회)	<ul style="list-style-type: none"> 중대재해처벌법 도입에 따른 공장 내 안전관리 강화 지역사회 기여 (문화예술나눔, 불우이웃돕기등)
G (지배구조)	<ul style="list-style-type: none"> 이사회 운영 강화 및 주주와의 소통 강화 기업가치제고계획(밸류업) 공시 도입



STAGE 4

별첨

별첨1. 3개년 연결 재무제표

■ 손익계산서

(단위: 억원)

	2023	2024	2025
매출액	3,636	3,110	4,249
매출원가	2,905	2,606	3,635
매출총이익	731	504	614
판관비	395	286	296
영업이익	336	219	318
기타수익	233	150	53
기타비용	125	76	166
금융수익	54	13	11
금융비용	56	32	42
당기순이익	309	213	204

■ 재무상태표

(단위: 억원)

	2023	2024	2025
유동자산	1,334	1,501	1,570
매각예정자산	72	69	69
비유동자산	2,019	2,300	2,402
자산 총계	3,425	3,871	4,042
유동부채	939	1,203	849
매각예정부채	-	-	-
비유동부채	16	45	436
부채총계	955	1,248	1,285
자본금	118	118	118
자본잉여금	634	634	634
기타자본구성요소	-185	-123	-123
이익잉여금	1,915	2,007	2,139
자본총계	2,470	2,624	2,757

KH VATEC®